

Bollettino Tecnico

Rev. 01/23

Koch Chemie Polish & Sealing Pad



La spugna con finitura extrafine per applicare uniformemente e in piccole quantità prodotti sigillanti come 1K Nano o Lack-Polish grün

PI.01. L'altezza ridotta di 23 mm crea basse forze di torsione, garantendo un'ottima maneggevolezza e il più alto livello di stabilità. La reticolazione ottimizzata (struttura cellulare aperta) e il conteggio delle cellule contribuiscono a un elevato livello di abrasività e a fattori igienici eccellenti. Il bordo di fresatura assicura una maggiore flessibilità per i cuscinetti, consentendo loro di adattarsi ai contorni più facilmente. Il materiale colorato basato su fibre non tessute è adatto per la levigatura e garantisce la sicurezza del processo. Durezza di compressione: 4. Abrasività: 2.

Area di utilizzo

-

Raccomandazioni per l'uso

-

Imballo

1 pz Ø 126 x 23 mm - 1 pz Ø 150 x 23 mm - 5pz Ø 45 x 23 mm

Utilizzatore

Non Professionista e Professionista.

Avviso:

Le informazioni e i dati riportati sono forniti in buona fede, ma non costituiscono valore di garanzia. Verificare l'idoneità e la compatibilità prima dell'uso; rimane sotto la responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità delle informazioni per il proprio uso. Saremo lieti di assistervi.